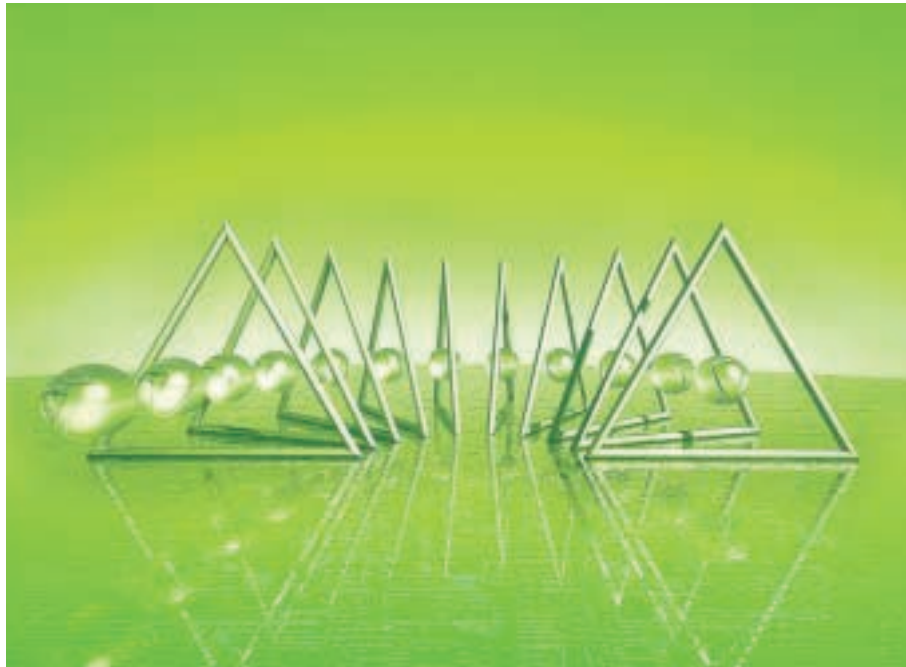


# 第40期 事業報告書

平成14年4月1日から  
平成15年3月31日まで



東京エレクトロン株式会社

## 株主のみなさまへ

株主のみなさまには、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご支援を賜り厚くお礼申し上げます。

当社第40期（平成14年4月1日から平成15年3月31日まで）事業報告書として、営業の概況等をご報告いたします。

## 営業の概況

当期の世界経済動向につきましては、当初一時的に回復基調を示しましたが、米国の会計不信問題、世界的株安の進行、イラク情勢等が引き金となり、欧米の景気は急速に減速しました。アジアにつきましては、中国は高い経済成長を示したものの、韓国、台湾等では緩やかなものへと変化してきました。日本経済につきましては、民間設備投資、個人消費の冷え込みが引き続き拡大するなど、景気は一層悪化しました。

当社の参画しておりますエレクトロニクス業界につきましては、DVDプレーヤーやデジタルカメラに代表されるデジタル家電の一部に需要回復が見られましたが、携帯電話、パソコン、通信の分野は低迷を続けております。半導体関連産業はこうした背景により、夏場以降、半導体メーカーの設備投資先送り、絞込みの動きが再び加速し、引き続き厳しい状況のまま推移しました。また、半導体メーカー間の事業再編の動きが加速しており、統合、寡占化が進んでおります。

こうしたなか、当社は人件費、経費の大幅抑制、製造開発拠点の再配置も含めた業務効率化にグループ一丸となって取り組みましたが、期末にかけて半導体メーカーからの納期延期、価格低下圧力に加え、アジアにおける中古市場の拡大が顕著となってきたことにより、商品在庫の滞留化が懸念されるなど、厳しいビジネス環境となりました。

当期の連結業績につきましては、売上高は4,605億8千万円（前期比10.2%増）となりましたが、たな卸資産評価損が増加したため、経常損失は2億3千万円となりました。また、現在の



## CONTENTS

株主のみなさまへ	1
主要な事業内容	3
半導体(IC)製造プロセス	4
CLOSE UP	5
業績等の推移	7
連結財務諸表	9
単独財務諸表	11
株式・社債の状況	13
役員等、会社の概況	14

株主メモ

半導体不況をシリコンサイクルのみならず構造問題であると判断し、事業構造改革の取組みとして、世界規模での拠点統廃合等に伴う資産処分および人員削減等を行うことを決定したため、これら一連の支出に備えるための特別損失を206億3千2百万円計上することとしました。また、期末時点での株価急落による有価証券評価損等もあり、税金等調整前当期純損失は230億1千万円となりました。加えて、繰延税金資産の回収可能性について判断した結果、その取崩等を行うことにより、185億3千2百万円の法人税等を計上したため、415億5千4百万円の当期純損失となりました。なお、単独業績につきましては、売上高3,693億8千4百万円（前期比11.1%増）、経常損失113億1千3百万円、当期損失431億6千1百万円となりました。

電子部品の販売を行っております子会社の東京エレクトロニクス株式会社につきましては、本年3月7日に東京証券取引所市場第二部へ上場いたしました。

## 会社が対処すべき課題

本年3月に始まったイラク戦争も短期終結となりましたが、世界経済の見通しについては不透明感が払拭される状況までには至っておらず、依然厳しい環境が予想されております。また、半導体関連業界におきましては、半導体メーカー間の再編、参入分野の選択と集中の動きがさらに鮮明になっているなか、半導体製造装置メーカーにおきましては、最高の独自技術と極限のコストを世界レベルで同時に達成するという課題をつきつけられております。

当社といたしましては、半導体設備投資が来期下半期から回復すると予想するものの、世界経済の動向によっては予断を許さない状況であるとの認識に立ち、売上高が当期の水準で当面推移するとした場合においても、利益を創出できる企業体質を早急に構築するための施策を実行することが急務と考えております。このため、すでに決定した事業構造改革の取組みの一環

といたしまして、世界規模での製造・開発拠点の統廃合をさらに推進し、グループ全体で千人規模の人員削減による固定費圧縮を行うとともに、グループ会社の再編を含めて組織の最適化を図ってまいります。

当社の参画する半導体および半導体製造装置産業は、シリコンサイクルと呼ばれる周期的な変動を繰り返しながら中長期的には成長し続ける産業であることに変わりはありませんが、今後そのなかでのプレーヤーは、世界規模で再編淘汰されていくことが必至であります。当社といたしましては、短期的にはこれらの諸施策を確実に実行し、かつ企業体質の強化を図り、真の「グローバル・エクセレント・カンパニー」すなわち強い国際競争力、高い成長力、活力あふれる力強い企業の構築を目指してまいります。

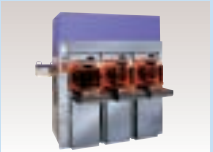


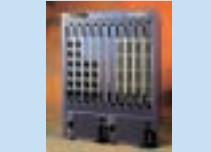


今後とも企業価値の最大化に努め、株主各位のご期待に応えてまいりますので、より一層のご支援とご理解をよろしくお願い申し上げます。

平成15年6月



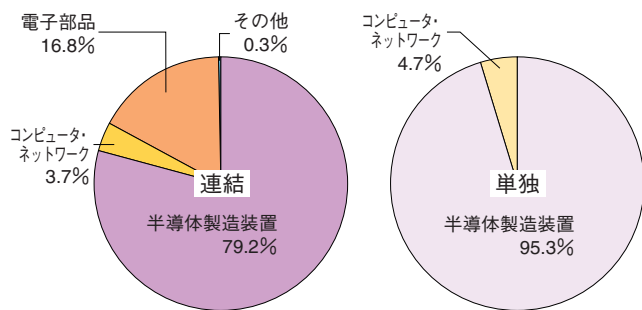
取締役会長 東 哲郎 (右側)  
取締役社長 佐藤 潔 (左側)

東京エレクトロングループは、エレクトロニクス技術を利用した半導体製造装置、コンピュータ・ネットワーク、電子部品等の製造・販売を事業の中心としております。各部門の営業の状況および主要な営業品目は、次のとおりであります。

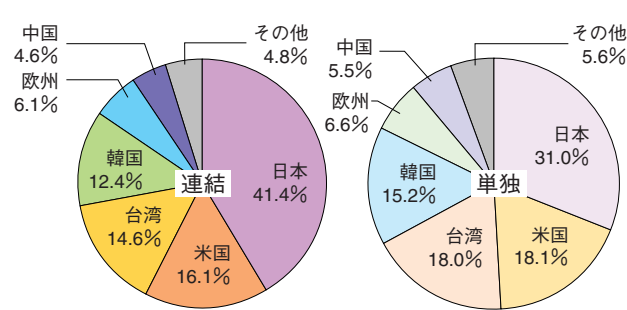
部 門	営業の状況および主要営業品目	
半導体製造装置	半導体市況低迷のなか、販売努力を継続しました。また、LCD製造装置が引き続き好調であったことから、当部門の売上高は3,646億8千9百万円（前期比12.0%増）となりました。	 高速ラジカル酸化プロセス対応 プラズマ処理装置Trias®SPA  300mmウェーハ対応25枚フレキシブル ロード型ホットウォールシステム TELFORMULA®
コンピュータ・ネットワーク	各種サーバー、高速ネットワーク技術製品の拡販に努めた結果、売上高171億9千2百万円（前期比0.9%増）となりました。	 ブロードコミュニケーションシステムズ社 Silksworm 12000  エクストリーム ネットワーク社 Gigabit ETHERNETスイッチ
電子部品 (東京エレクトロデバイス株式会社)	パソコン、通信、ネットワーク関連機器向けの最先端デバイスの拡販に努めた結果、売上高773億8千万円（前期比5.1%増）となりました。	 富士通株 ASIC, MPU, MCU, メモリ, ASSP, 通信用IC, LCD  ザイリンクス社 FPGA, CPLD

製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

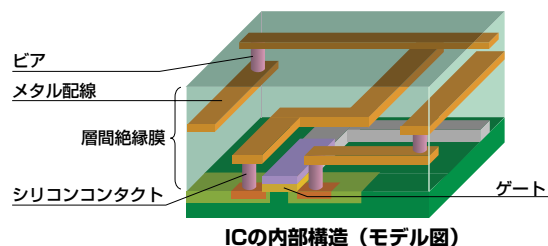
■当期部門別売上構成比



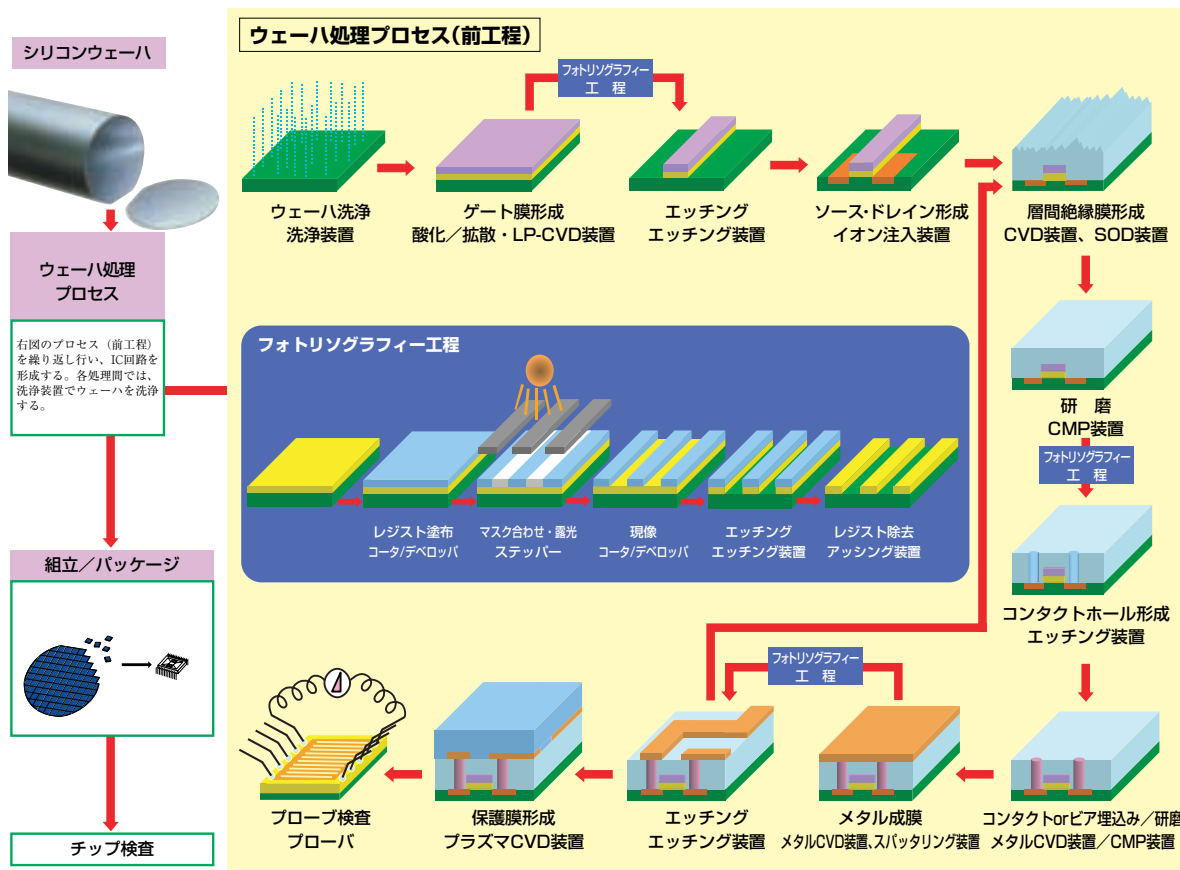
■当期地域別売上構成比



半導体は、たくさんのトランジスタや抵抗などの素子とそれらをつなぐ配線からなる複雑な構造となっております（右モデル図参照）。また、その製造プロセスは、主にシリコンウェーハ上に金属や絶縁体の薄膜を重ね合わせることで、不要な部分を削り取ることを繰り返して回路を形成する前工程と、組立・パッケージングを行う後工程の二つに分けられます。当社はこのうち、前工程のほぼ全てをカバーする製品群をラインアップし、お客様より高い評価をいただいています。



ICの内部構造 (モデル図)



## 用語解説

### CVD (Chemical Vapor Deposition)

ウェーハ表面に原料となるガスを流し、熱やプラズマを利用して化学反応で薄膜を堆積させる技術。

### エッチング

CVDなどで成膜した薄膜を化学反応で取り去る技術。

### SOD (Spin on Deposition)

配線と配線の間を埋める絶縁膜を液体の原料を用いて回転塗布法で成膜する技術。

### CMP (Chemical Mechanical Polishing)

機械的加工と化学反応により形成した薄膜を平坦化する技術。

# フォトリソグラフィ分野で世界シェアNo.1 ～塗布/現像装置ビジネスのご紹介～

近年、我々にますます身近になっている携帯電話やパソコンの中を開けてみると、IC（集積回路）と呼ばれる小さな半導体部品が組み込まれています。家電製品や自動車にも多くのICが組み込まれるようになり、ICは我々の生活から欠かせないものになっています。ICは、従来のトランジスタやコンデンサ・抵抗などの集積体を小型化したもので、シリコンウェーハと呼ばれる、薄い金属板の表面に作られます。シリコンウェーハ表面には、様々な特性を持つ薄い膜を形成し、露光装置により回路を焼きつけ、その一部分を削るといった一連の工程を繰り返すことで、半導体は製造されます（※1）。このうち半導体の回路を焼きつける工程は、一般的にフォトリソグラフィ工程と呼ばれ、塗布/現像装置は、感光剤の塗布・現像をする役割を担っています。また塗布/現像装置の塗布技術は、感光剤の塗布だけでなく、層間絶縁膜・保護膜などの成膜技術としても応用されています。

※1 半導体（IC）製造プロセスについては前頁をご参照ください。

## レジスト塗布工程

半導体製造には、回路を焼きつけるフォトリソグラフィ工程で、シリコンウェーハ上に感光剤を塗布する処理が必要になります。この感光剤は、一般的に、「フォトレジスト」、または、「レジスト」と呼ばれています。塗布/現像装置は、このレジストをウェーハ上に滴下し、ウェーハを回転させ、その遠心力により、レジストをウェーハ全面に均一に広げることができます。その後、ホットプレート上で乾燥させ、ウェーハ上にレジストを付着させます。



レジストは、回転塗布の際にほとんどが飛び散ってしまいます。レジストはとても高価な材料である為、半導体を製造する際には、レジストの消費量を出来る限り少なくする必要があります。当社は塗布/現像装置において、レジストを塗布する前に溶剤を塗ることで塗布性能を高めた、省レジスト技術を確立しています。これにより従来のレジスト消費量の1/3以下まで使用量を削減することが可能になりました。

## 現像工程

ウェーハ上に均一に塗布された感光剤に露光機と呼ばれる装置によって回路が転写されます。その露光された部分を薬液（現像液）で溶かす工程を現像工程と呼びます。この工程で溶けずに残った部分を、エッチングと呼ばれる工程で削り取り、ウェーハ表面上に残った部分が最終的に回路になります。この現像工程では、現像液の、ソフトで均一な液盛りが重要になり、生産性・プロセスの安定性を確保する為に、現像液を出すノズルに工夫をしています。



## 層間絶縁膜塗布

当社では、レジスト塗布/現像装置で培ってきたスピン塗布技術を、絶縁膜の塗布技術にも応用しています。これまで行っていた、絶縁膜の成膜技術の化学的気相成長法(CVD)に代用される技術として注目を集め、更なる微細化に伴って、市場に広く展開される可能性が高まっています。当社では、このスピン塗布法による装置の簡便性に目を向け、今まで培ってきた実績において裏付けられた装置の稼働率・信頼性を更に強化し、より実用性の高い装置開発を進めています。

## 次世代300mm塗布/現像装置

2002年12月に、次世代300mmプロセス対応レジスト塗布/現像装置“CLEAN TRACK LITHIUS™”を発表しました。CLEAN TRACK LITHIUS™は、プロセス性能だけでなく、装置生産の構造をも見直し、受注から納入までのリードタイムを短縮しています。更に近年、注目されているAPC・e-Diagnostics(※2)などの新技術を搭載しました。これらにより、これまで以上に、プロセス性能・生産性・信頼性・自動化といった装置性能をバランスよく高めています。

※2 APC (Advanced Process Control) : 半導体製造プロセスのモニタリングおよび自動制御を行う技術  
e-Diagnostics : 半導体製造装置の稼働状態を遠隔診断する技術



東京エレクトロン九州(株)合志事業所



次世代300mmプロセス対応レジスト塗布/現像装置  
CLEAN TRACK LITHIUS™

## シェアNo.1のリーディングカンパニーとして

当社におけるレジスト塗布/現像装置ビジネスは、1980年代でのCLEAN TRACK MARKシリーズの市場展開から飛躍的に伸び続け、1996年から展開したCLEAN TRACK ACT®シリーズでは、常に業界のトップシェアを維持しています。現在、世界シェアは80%を超え(※3)、リーディングカンパニーとしての責任を全うすべく新しい技術の研究/開発を推進しています。当社の製品は、装置開発の段階から、ランニングコストの削減・安全仕様にも力を入れ、社内教育やISO14001(※4)の取得など、環境や安全面に力を注いでいます。

開発・製造は、東京エレクトロン九州(株)の合志事業所、熊本事業所で行っています。

※3 当社推定

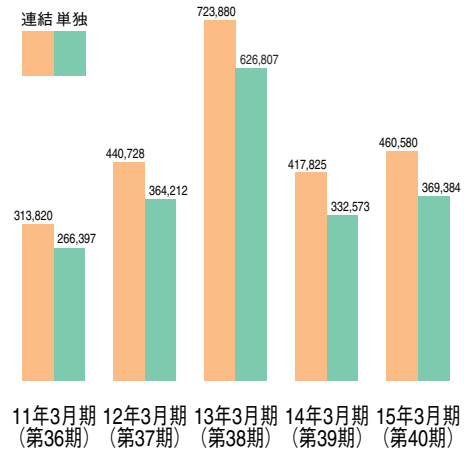
※4 ISO14001:環境マネジメントシステムの国際規格

## 連結

区分	期別		第40期 平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで
	第38期 平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	第39期 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	
売上高（百万円）			
半導体製造装置	619,001	325,715	364,689
コンピュータ・ネットワーク	14,053	17,031	17,192
電子部品	89,210	73,657	77,380
その他	1,614	1,421	1,317
合計	723,880	417,825	460,580
経常利益（百万円）	119,223	△ 19,464	△ 230
当期純利益（百万円）	62,011	△ 19,938	△ 41,554
総資産（百万円）	729,511	556,915	524,901
株主資本（百万円）	333,281	307,578	252,904
1株当たり当期純利益（円）	353.76	△ 113.85	△ 238.57

(注) △は、損失を示しております。

## ■売上高（百万円）

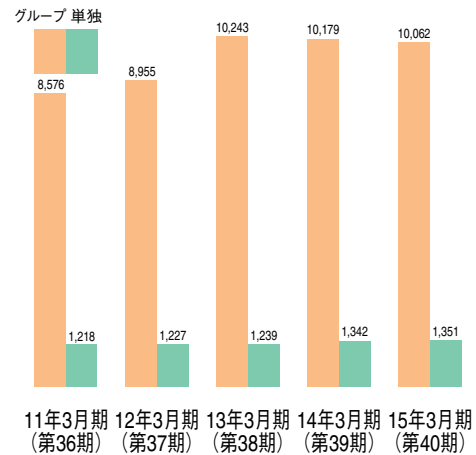


## 単独

区分	期別		第40期 平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで
	第38期 平成12年4月1日から 平成13年3月31日まで	第39期 平成13年4月1日から 平成14年3月31日まで	
売上高（百万円）			
半導体製造装置	612,540	315,510	352,150
コンピュータ・ネットワーク	14,267	17,063	17,234
合計	626,807	332,573	369,384
経常利益（百万円）	59,698	△ 9,564	△ 11,313
当期利益（百万円）	30,934	△ 6,836	△ 43,161
総資産（百万円）	601,416	487,022	461,521
株主資本（百万円）	285,638	269,408	216,055
1株当たり当期利益（円）	176.08	△ 39.04	△ 247.73
1株当たり配当金（円）	38.00	8.00	8.00

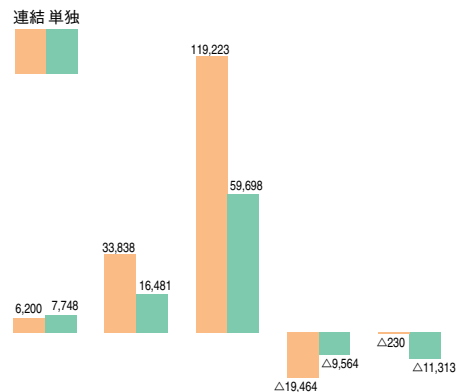
(注) △は、損失を示しております。

## ■従業員数（名）





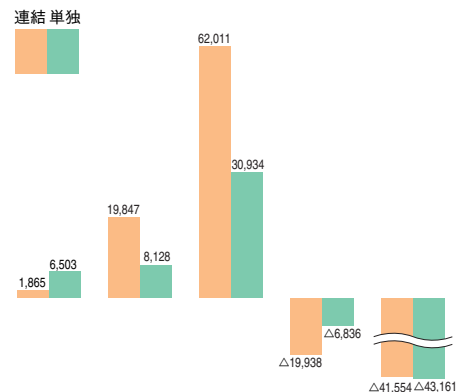
■経常利益（百万円）



11年3月期 (第36期) 12年3月期 (第37期) 13年3月期 (第38期) 14年3月期 (第39期) 15年3月期 (第40期)

(注) △は、損失を示しております。

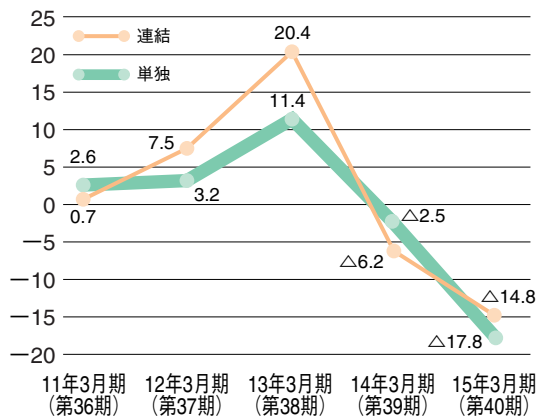
■当期利益（百万円）



11年3月期 (第36期) 12年3月期 (第37期) 13年3月期 (第38期) 14年3月期 (第39期) 15年3月期 (第40期)

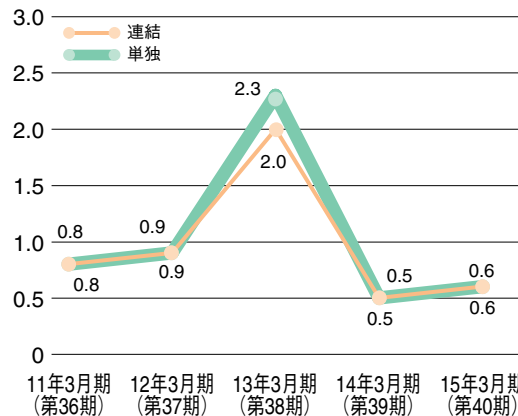
(注) △は、損失を示しております。

■株主資本当期利益率（％）



11年3月期 (第36期) 12年3月期 (第37期) 13年3月期 (第38期) 14年3月期 (第39期) 15年3月期 (第40期)

■株主資本配当率（％）



11年3月期 (第36期) 12年3月期 (第37期) 13年3月期 (第38期) 14年3月期 (第39期) 15年3月期 (第40期)

比較連結貸借対照表

資産の部	当期末	前期末
	百万円	百万円
<b>流動資産</b>	<b>356,438</b>	<b>353,423</b>
現金及び預金	52,982	48,409
受取手形及び売掛金	170,286	157,414
たな卸資産	111,810	127,352
繰延税金資産	4,151	3,401
その他	17,549	17,465
貸倒引当金	△ 341	△ 620
<b>固定資産</b>	<b>168,462</b>	<b>203,491</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>119,611</b>	<b>134,510</b>
建物及び構築物	59,655	68,498
機械装置及び運搬具	28,510	29,643
工具器具及び備品	9,246	11,322
土地	19,718	19,907
建設仮勘定	2,479	5,138
<b>無形固定資産</b>	<b>25,342</b>	<b>28,753</b>
連結調整勘定	15,031	16,929
その他	10,310	11,823
<b>投資その他の資産</b>	<b>23,509</b>	<b>40,227</b>
投資有価証券	7,216	9,535
長期貸付金	85	83
繰延税金資産	9,362	22,591
その他	7,277	8,303
貸倒引当金	△ 431	△ 285
<b>資産合計</b>	<b>524,901</b>	<b>556,915</b>

負債の部	当期末	前期末
	百万円	百万円
<b>流動負債</b>	<b>160,705</b>	<b>109,501</b>
支払手形及び買掛金	36,676	26,625
短期借入金	10,651	20,311
コマースル・ペーパー	35,000	10,000
一年以内償還予定社債	20,000	20,000
一年以内償還予定転換社債	15,481	—
未払法人税等	3,645	1,663
賞与引当金	3,629	2,463
事業構造改革損失引当金	8,577	—
新株引受権	1,273	694
その他	25,771	27,744
<b>固定負債</b>	<b>107,695</b>	<b>139,776</b>
社債	60,000	80,000
転換社債	—	15,500
長期借入金	10,229	9,951
退職給付引当金	35,317	31,714
役員退職慰労引当金	1,074	1,269
新株引受権	—	624
その他	1,074	716
<b>負債合計</b>	<b>268,401</b>	<b>249,278</b>
<b>少数株主持分</b>	<b>3,595</b>	<b>58</b>
<b>資本の部</b>		
<b>資本金</b>	<b>47,223</b>	<b>47,213</b>
資本剰余金	70,285	70,275
利益剰余金	147,464	190,195
その他有価証券評価差額金	△ 58	1,170
為替換算調整勘定	1,228	3,737
自己株式	△ 13,238	△ 5,014
<b>資本合計</b>	<b>252,904</b>	<b>307,578</b>
<b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>	<b>524,901</b>	<b>556,915</b>

- (注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 有形固定資産の減価償却累計額（当期末） 111,474百万円  
 3. 自己株式数（当期末） 2,034,755株  
 4. 連結財務諸表規則の改正にもとづき、前期の資本の部につきましては、改正後の表示区分に組み替えております。

## 比較連結損益計算書

科 目	当 期	前 期
	百万円	百万円
売上高	460,580	417,825
売上原価	326,539	302,270
売上総利益	134,040	115,555
販売費及び一般管理費	132,921	133,865
営業利益	1,118	△ 18,310
営業外収益	2,208	1,796
受取利息	133	294
受取配当金	57	56
固定資産賃貸料	867	797
その他	1,149	647
営業外費用	3,557	2,950
支払利息	1,601	1,959
固定資産賃貸費用	516	501
為替差損	503	340
その他	936	147
経常利益	△ 230	△ 19,464
特別利益	624	1,471
前期損益修正益	29	152
貸倒引当金戻入益	244	1,138
固定資産売却益	100	180
国庫補助金等受入益	250	—
特別損失	23,405	4,927
固定資産売却・除却損	1,746	851
貸倒引当金繰入額	185	54
事業構造改革費用	12,055	—
事業構造改革損失引当金繰入額	8,577	—
投資有価証券評価損	738	1,235
事業構造改善費用	—	2,671
その他	102	114
税金等調整前当期純利益	△ 23,010	△ 22,919
法人税、住民税及び事業税	4,805	2,612
法人税等調整額	13,726	△ 5,602
少数株主利益	12	8
当期純利益	△ 41,554	△ 19,938

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. △は、損失を示しております。

3. 1株当たり当期純利益(当期)

△ 238円57銭

4. 1株当たり株主資本(当期)

1,456円23銭

## 連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	当 期	前 期
	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,393	77,558
税金等調整前当期純利益(△損失)	△ 23,010	△ 22,919
減価償却費	27,373	26,294
連結調整勘定償却額	1,897	1,897
退職給付引当金の増加額	3,611	3,002
役員退職慰労引当金の増減額(△減少)	△ 195	161
貸倒引当金の減少額	△ 123	△ 1,072
賞与引当金の増減額(△減少)	△ 1,166	△ 8,500
受取利息及び受取配当金	△ 191	△ 350
支払利息	1,605	1,979
為替差損益(△差益)	287	△ 187
前期損益修正益	△ 29	△ 152
固定資産売却損益(△益)	△ 61	△ 180
固定資産等除却損	1,706	850
事業構造改革費用	12,055	—
事業構造改革損失引当金繰入額	8,577	—
投資有価証券評価損	738	1,235
ゴルフ会員権評価損	—	75
売上債権の増減額(△増加)	△ 13,661	131,251
たな卸資産の増減額(△増加)	△ 3,890	28,359
仕入債務の増減額(△減少)	10,351	△ 34,166
未収消費税等の増減額(△増加)	△ 926	3,901
役員賞与の支払額	—	△ 756
その他	△ 3,881	△ 7,698
小計	23,400	123,025
利息及び配当金の受取額	190	350
利息の支払額	△ 1,670	△ 1,970
法人税等の支払額	△ 527	△ 43,848
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,269	△ 35,789
定期預金の払戻による収入	—	30
有形固定資産の取得による支出	△ 7,028	△ 31,006
有形固定資産の売却による収入	2,732	1,605
無形固定資産の取得による支出	△ 2,779	△ 5,390
無形固定資産の売却による収入	61	20
投資有価証券の取得による支出	△ 606	△ 21
貸付けによる支出	△ 38	△ 29
貸付金の回収による収入	39	73
その他	348	△ 1,070
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,883	△ 57,213
短期借入金の純増減額(△減少)	△ 4,828	△ 34,795
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△減少)	25,000	△ 20,000
長期借入れによる収入	3,000	37
長期借入金の返済による支出	△ 7,183	△ 3,017
社債の発行による収入	—	6,094
社債の償還による支出	△ 20,000	—
自己株式の純増加額	△ 8,223	△ 1,495
配当金の支払額	△ 1,395	△ 4,030
連結子会社の公募増資による収入	3,750	—
その他	△ 3	△ 5
現金及び現金同等物に係る換算差額	332	△ 1,436
現金及び現金同等物の増減額(△減少)	4,573	△ 16,881
現金及び現金同等物の期首残高	48,409	65,290
現金及び現金同等物の期末残高	52,982	48,409

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. △は、現金及び現金同等物の流出を示しております。

連結範囲及び持分法の適用に関する事項(当期)

連結子会社数	28社
持分法適用非連結子会社数	0社
持分法適用関連会社数	1社

比較貸借対照表

資産の部	当期末	前期末
	百万円	百万円
<b>流動資産</b>	<b>368,093</b>	<b>371,349</b>
現金及び預金	46,434	39,969
受取手形	381	5,496
売掛金	148,679	130,509
未収金	11,434	11,645
有価証券	—	10
商品	47,274	46,319
貯蔵品	61	759
前払費用	868	731
前渡金	1,202	1,047
短期貸付金	108,345	128,782
繰延税金資産	—	1,374
その他の流動資産	3,781	5,469
貸倒引当金	△ 371	△ 766
<b>固定資産</b>	<b>93,428</b>	<b>115,673</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>34,164</b>	<b>34,434</b>
建物	11,335	12,335
構築物	255	293
機械装置	5,442	4,056
車両運搬具	4	0
工具器具及び備品	2,149	2,458
土地	14,842	14,840
建設仮勘定	134	449
<b>無形固定資産</b>	<b>8,015</b>	<b>8,945</b>
特許権	4,429	4,165
ソフトウェア	3,183	2,635
その他の無形固定資産	402	2,144
<b>投資等</b>	<b>51,248</b>	<b>72,293</b>
投資有価証券	5,716	6,880
子会社株式	40,875	45,309
長期貸付金	2,043	6,471
長期前払費用	1,120	1,569
長期差入保証金	2,088	2,170
繰延税金資産	—	9,667
その他の投資	1,157	1,316
貸倒引当金	△ 1,753	△ 1,091
<b>資産合計</b>	<b>461,521</b>	<b>487,022</b>

負債の部	当期末	前期末
	百万円	百万円
<b>流動負債</b>	<b>169,577</b>	<b>108,953</b>
買掛金	65,274	52,453
短期借入金	1,448	1,514
コマーシャル・ペーパー	35,000	10,000
一年以内償還予定社債	20,000	20,000
一年以内償還予定転換社債	15,481	—
未払金	17,889	18,795
未払法人税等	520	15
未払費用	242	221
前受収益	43	132
前受金	1,391	1,551
預り金	6,439	2,721
賞与引当金	776	482
訴訟損失引当金	73	—
取引責任損失引当金	869	—
事業構造改革損失引当金	2,714	—
新株引受権	1,273	694
その他の流動負債	138	371
<b>固定負債</b>	<b>75,888</b>	<b>108,661</b>
社債	60,000	80,000
転換社債	—	15,500
長期借入金	1,000	1,800
繰延税金負債	424	—
退職給付引当金	10,343	9,230
役員退職慰労引当金	430	450
預り保証金	0	0
新株引受権	—	624
子会社投資等損失引当金	3,689	1,056
<b>負債合計</b>	<b>245,466</b>	<b>217,614</b>
<b>資本の部</b>		
資本金	47,223	47,213
資本剰余金	70,285	70,275
資本準備金	70,285	70,275
<b>利益剰余金</b>	<b>111,598</b>	<b>156,155</b>
利益準備金	5,660	5,660
特別償却準備金	586	684
別途積立金	147,500	147,500
当期末処分利益(△未処理損失)	△ 42,147	2,309
(うち当期利益(△損失))	(△ 43,161)	(△ 6,836)
<b>株式等評価差額金</b>	<b>186</b>	<b>778</b>
自己株式	△ 13,238	△ 5,014
<b>資本合計</b>	<b>216,055</b>	<b>269,408</b>
<b>負債・資本合計</b>	<b>461,521</b>	<b>487,022</b>

(注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 子会社に対する短期金銭債権(当期末) 114,246百万円  
 子会社に対する長期金銭債権(当期末) 1,995百万円  
 子会社に対する短期金銭債務(当期末) 72,678百万円  
 3. 有形固定資産の減価償却累計額(当期末) 28,239百万円

4. 保証債務等(当期末) 4,710百万円  
 5. 外貨建資産及び負債の主なもの  
 子会社株式(当期末) 29,164百万円  
 (227,306千ドルほか)  
 6. 商法施行規則の改正にもとづき、前期の資本の部につきましては、改正後の表示区分に組み替えております。

## 比較損益計算書

科 目		当 期	前 期
		百万円	百万円
経常	営業収益	369,384	332,573
	売上高	369,384	332,573
	営業費用	384,212	346,215
	売上原価	339,654	301,942
	販売費及び一般管理費	44,557	44,272
	営業利益	△ 14,827	△ 13,641
	営業外収益	6,123	6,976
	受取利息	852	1,195
	受取配当金	2,422	3,343
	固定資産賃貸料	2,106	2,038
雑収入	742	398	
営業外費用	2,609	2,899	
支払利息	61	76	
社債利息	1,239	1,487	
社債発行費	—	37	
固定資産賃貸費用	896	956	
雑支出	412	341	
経常利益	△ 11,313	△ 9,564	
特別利益	366	1,158	
固定資産売却益	46	100	
貸倒引当金戻入益	320	1,058	
特別損失	19,533	4,057	
固定資産売却・除却損	1,295	523	
事業構造改革費用	8,561	—	
子会社株式売却損	2,931	—	
事業構造改革損失引当金繰入額	2,714	—	
子会社投資等損失引当金繰入額	2,633	1,056	
投資有価証券評価損	738	1,235	
貸倒引当金繰入額	614	861	
ゴルフ会員権評価損	44	46	
子会社株式評価損	—	299	
その他の特別損失	—	34	
税引前当期利益	△ 30,480	△ 12,462	
法人税、住民税及び事業税	777	25	
法人税等調整額	11,903	△ 5,652	
当期利益	△ 43,161	△ 6,836	
前期繰越利益	1,708	9,846	
中間配当額	694	700	
当期末処分利益	△ 42,147	2,309	

- (注) 1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。  
2. △は、損失を示しております。  
3. 子会社に対する売上高(当期) 18,952百万円  
子会社よりの仕入高(当期) 291,281百万円  
子会社との営業取引以外の取引高(当期) 6,358百万円

## 比較利益処分

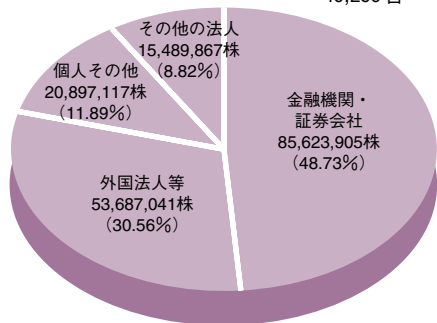
科 目	当 期	前 期
	円	円
当期末処分利益(△損失)	△ 42,147,823,054	2,309,955,579
任意積立金取崩高	43,169,230,705	172,447,407
特別償却準備金	169,230,705	172,447,407
別途積立金	43,000,000,000	—
合 計	1,021,407,651	2,482,402,986
利益処分額	700,834,298	774,174,122
株主配当金	694,652,700	700,344,144
任意積立金	—	—
特別償却準備金	6,181,598	73,829,978
次期繰越利益	320,573,353	1,708,228,864

- (注) 1. 平成14年12月9日に694,736,000円(1株につき4円)の中間配当を実施いたしました。  
2. 特別償却準備金は、租税特別措置法に基づくものであります。
- 重要な会計方針(当期)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法  
子会社株式：総平均法による原価法によっております。  
その他有価証券  
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)によっております。  
時価のないもの：総平均法による原価法によっております。  
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法(ただし、保守用部品及び貯蔵品については先入先出法)による原価法を採用しております。  
3. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法)を採用しております。  
無形固定資産：定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。  
4. 繰延資産の処理方法  
新株発行費は、支出年度の費用として処理しております。  
5. 引当金の計上基準  
① 賞 倒 引 当 金：債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。  
② 賞 与 引 当 金：従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額により計上しております。  
③ 退職 給 付 引 当 金：従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、計上しております。  
過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、費用処理しております。  
数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(4年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の際から費用処理しております。  
④ 役員退職慰労引当金：取締役等に対する賞与の支給に備えるため、当社内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、これは高法第287条ノ2に規定する引当金であります。  
⑤ 子会社投資等損失引当金：子会社への投資等に係る損失に備えるため、当該子会社の資産内容を勘案し、損失負担見込額を計上しております。なお、これは高法第287条ノ2に規定する引当金であります。  
⑥ 訴訟 損 失 引 当 金：係争中の訴訟に係る損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込額を計上しております。なお、これは高法第287条ノ2に規定する引当金であります。  
⑦ 取引責任損失引当金：取引商品に対する取引責任に伴う将来の損失に備えるため、その経過等の状況に基づく損失負担見込額を計上しております。なお、これは高法第287条ノ2に規定する引当金であります。  
⑧ 事業構造改革損失引当金：事業構造改革計画の実行に伴い、今後発生の見込まれる損失に備えるため、当該損失見込額を計上しております。なお、これは高法第287条ノ2に規定する引当金であります。
  6. リース取引の処理方法  
リース物件の所有権が借主に転移すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
  7. ヘッジ会計の方法  
① ヘッジ会計の方法  
繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。  
② ヘッジ手段とヘッジ対象  
ヘッジ手段：デリバティブ取引(先物為替予約)  
ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引  
③ ヘッジ方針  
原則、外貨建取引は、取引成約時(予定取引を含む)に成約高の範囲内で先物為替予約を利用することにより、為替変動リスクをヘッジしております。  
④ ヘッジの有効性評価の方法  
キャッシュ・フロー変動の累計額を比率分析しております。
  8. 消費税等の会計処理の方法  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
  9. 会計方針の変更  
当期より、「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。  
また、当期より、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。これによる影響はありません。

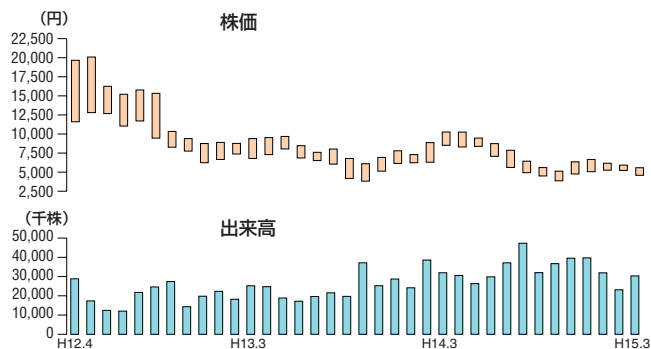
### 株式の状況 (平成15年3月31日現在)

会社が発行する株式の総数	300,000,000株
発行済株式の総数	175,697,930株
資本金	47,223,246,393円
株主数	49,259名

#### 所有者別状況



### 株価と出来高 (平成12年4月～平成15年3月)



### 大株主 (平成15年3月31日現在)

株主名	当社への出資状況		当社の当該株主への出資状況	
	持株数 千株	議決権比率 %	持株数 千株	議決権比率 %
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	18,419	10.62	—	—
株式会社東京放送	14,921	8.60	1,774	1.07
日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口)	12,330	7.11	—	—
ザチェースマンハッタンバンク エヌエイロンドン エスエルオムニバス アカウント	6,860	3.95	—	—
UFJ信託銀行株式会社(信託勘定A口)	5,421	3.12	—	—
ザチェースマンハッタンバンク エヌエイロンドン	5,301	3.06	—	—
第一生命保険相互会社	5,100	2.94	—	—
日本生命保険相互会社	4,240	2.44	—	—
ステートストリートバンクアドトラスト カンパニー	3,794	2.19	—	—
ポストンセーフデポジットビーエスディーティーリーティー クライアantz オムニバス	3,127	1.80	—	—

### 社債の状況 (平成15年3月31日現在)

#### 1. 社債

銘柄	発行日	発行総額	利率	償還期限	未償還残高
第7回無担保社債	平成11年7月23日	200億円	1.39%	平成16年7月23日	200億円
第8回無担保社債	平成12年8月18日	200億円	0.85%	平成15年8月18日	200億円
第9回無担保社債	平成12年8月18日	300億円	1.30%	平成17年8月18日	300億円

#### 2. 新株引受権付社債

銘柄	発行日	発行総額	利率	償還期限	行使価額	行使率
第4回無担保新株引受権付社債	平成12年6月9日	45億円	1.59%	平成18年6月9日	14,070円	—%
第5回無担保新株引受権付社債	平成13年6月8日	55億円	0.86%	平成19年6月8日	9,608円	—%

#### 3. 転換社債

銘柄	発行日	発行総額	利率	償還期限	転換価額	転換率
第2回無担保転換社債	平成6年4月27日	300億円	0.90%	平成15年9月30日	3,150円	48.40%

(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 証券取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」制度に基づき、キャピタル・ゲルディアン・トラスト・カンパニーおよびその関連会社である他4社から平成15年1月31日付で提出された変更報告書により平成15年1月28日現在、23,327千株所有している旨、また、フィデリティ投信株式会社から平成15年1月15日付で提出された変更報告書により平成14年12月31日現在、11,285千株所有している旨の報告を受けておりますが当社として平成15年3月31日現在の所有株式数の確認ができない部分については上記表に含めておりません。  
 3. 株式会社東京放送の持株数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式1,694千株(議決権比率0.98%)を含んでおります(株主名簿上の名義は「包括信託受託者三井アセット信託銀行(委託者株式会社東京放送)」であります。)  
 4. ザチェースマンハッタンバンク エヌエイロンドン エスエルオムニバス アカウント、ザチェースマンハッタンバンク エヌエイロンドン、ステートストリートバンクアドトラスト カンパニーおよびポストンセーフデポジットビーエスディーティーリーティー クライアantz オムニバスは、主として欧米の機関投資家の所有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっております。



## 役員等

### 取締役および監査役 (平成15年6月20日現在)

代表取締役会長	東 哲郎
取締役副会長	常石 哲男
代表取締役社長	佐藤 潔
代表取締役	原 護
取締役	田中 健生
取締役	石橋 寛介
取締役(社外)	砂原 幸雄
取締役(社外)	近藤 俊之
常勤監査役	糸山 武敏
常勤監査役	鈴木 孝則
常勤監査役	木村富司 雄博
監査役	前田 博

(注) 監査役のうち木村富司雄氏および前田 博氏は、商法特例法に定める社外監査役であります。

### 執行役員 (平成15年6月20日現在)

社 長	佐藤 潔	執行役員	鷲野 憲治
専務執行役員	原 護	執行役員	竹中 博司
常務執行役員	小野里 充	執行役員	井上 芳徳
常務執行役員	小松原隆一	執行役員	富田 博
執行役員	阪本甚三郎	執行役員	天野 勝之
執行役員	白肌 久志	執行役員	古垣 圭一
執行役員	久我 宣之	執行役員	山口 千明
執行役員	原田 芳輝	執行役員	小松 孝弘
執行役員	児玉 孝雄	執行役員	春原 清
執行役員	伊東 晃	執行役員	石川 陽一
執行役員	伊藤 高司	執行役員	田原 好文
執行役員	栗木 康幸	執行役員	鮑本 正巳

## 会社の概況

### 会社の概況 (平成15年3月31日現在)

商 号	東京エレクトロン株式会社 TOKYO ELECTRON LIMITED
設 立	昭和38年11月11日
資 本 金	47,223,246,393円
本 社	東京都港区赤坂五丁目3番6号
主要な事業所	
府中テクノロジーセンター	東京都府中市住吉町2丁目30番7号
大阪支社	大阪府大阪市淀川区宮原3丁目4番30号
関西テクノロジーセンター	兵庫県尼崎市扶桑町1番8号
九州支社	熊本県菊池郡菊陽町津久礼2655番地
山梨事業所	
(藤井地区)	山梨県韮崎市藤井町北下条2381番地の1
(穂坂地区)	山梨県韮崎市穂坂町三ッ沢650番地
営業所	名古屋



本社 (TBS放送センター-15・16・17・18F)

## 株主メモ

---

決算期	毎年3月31日
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会については、毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告する一定の日
配当支払株主確定日	利益配当金 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日
1単元の株式の数	100株
名義書換代理人	東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
(郵便物送付先) (電話照会先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社証券代行部 証券代行事務センター ☎(03) 3323-7111
同取次所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店
単元未満株式の 買取請求取扱 公告の方法	上記名義書換代理人および同取次所 日本経済新聞に掲載 ただし、貸借対照表および損益計算書は、 当社インターネットホームページにおいて 提供します。
上場証券取引所	東京証券取引所 市場第一部 (証券コード 8035)

